

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ASMPPT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0522)

二零二四年中期業績新聞稿

有關 ASMPPT Limited 及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月業績的新聞稿附載於本公告。

承董事會命
董事
黃梓達

香港，二零二四年七月二十四日

於本公告日期，本公司董事會成員包括獨立非執行董事：Orasa Livasiri 小姐（主席）、樂錦壯先生、黃漢儀先生、鄧冠雄先生、張仰學先生及蕭潔雲女士；非執行董事：Hichem M'Saad 博士及 Paulus Antonius Henricus Verhagen 先生；執行董事：黃梓達先生及 Guenter Walter Lauber 先生。

(本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。)

ASMPT 公布二零二四年中期業績

先進封裝：訂單勢頭強勁

集團業績概覽**集團財務概要：二零二四年第二季度**

- * 銷售收入為港幣 33.4 億元(4.27 億美元)，按年-14.3%，按季則+6.5%
- * 新增訂單總額為港幣 31.2 億元(3.99 億美元)，按年+3.5%，按季則-2.4%
- * 毛利率為 40.0%，按年-6 點子，按季亦-184 點子
- * 經營利潤率為 4.0%，按年-587 點子，按季亦-360 點子
- * 盈利為港幣 1.37 億元，按年-55.6%，按季亦-23.0%
- * 每股基本盈利為港幣 0.33 元，按年-56.0%，按季亦-23.3%

集團財務概要：二零二四年上半年

- * 銷售收入為港幣 64.8 億元(8.29 億美元)，按年-17.1%，按半年亦-5.8%
- * 新增訂單總額為港幣 63.2 億元(8.09 億美元)，按年-3.6%，按半年則+11.0%
- * 毛利率為 40.9%，按年+67 點子，按半年亦+276 點子
- * 經營利潤率為 5.8%，按年-512 點子，按半年則+212 點子
- * 盈利為港幣 3.14 億元，按年-49.6%，按半年則+255.2%
- * 每股中期基本盈利為港幣 0.76 元，按年-50.0%，按半年則+245.5%
- * 中期股息每股港幣0.35元，按年-42.6%
- * 於二零二四年六月三十日，未完成訂單總額為港幣64.0億元 (8.20億美元)

非香港財務報告準則計量¹

- * 二零二四年上半年經調整盈利為港幣 3.15 億元(按年-49.5%，按半年則+158.1%)，二零二四年第二季度為港幣 1.37 億元(按季-22.7%，按年亦-55.5%)
- * 二零二四年上半年經調整每股基本盈利為港幣 0.76 元(按年-50.0%，按半年則+153.3%)，二零二四年第二季度為港幣 0.33 元(按季-23.3%，按年亦-56.0%)

二零二四年第三季度銷售收入預測

- * 將介乎 3.7 億美元至 4.3 億美元之間，以其中位數計按年-9.9%，按季亦-6.4%

詳盡業績公告及投資者簡報可見於

<https://www.asmpt.com/zh-tw/investors/financials-results/>

¹ 二零二三年第二季度、二零二三年上半年及二零二四年第一季度皆無相應的非香港財務報告準則調整。有關非香港財務報告準則計量之詳情，請參閱業績公告中的「香港財務報告準則計量與非香港財務報告準則計量之對賬」章節。

(二零二四年七月二十四日，香港訊) — **ASMPT Limited** (「ASMPT」 / 「集團」 / 「公司」) (股份代號：0522)，一間全球領先之半導體和電子產品製造的硬件和軟件解決方案供應商，公布集團截至二零二四年六月三十日止六個月之中期業績。集團第二季度銷售收入高於預測的中位數。

集團行政總裁黃梓達先生表示：「我們獨特及廣泛的產品組合以及領先行業的解決方案使我們能夠把握新興趨勢，在半導體行業整體表現各異的情況下保持競爭優勢。值得注意的是，我們的先進封裝（「AP」）解決方案的需求激增，訂單勢頭強勁，特別是由生成式人工智能和高性能計算（「HPC」）推動的熱壓焊接（「TCB」）。我們業務模式的優勢及韌性使我們能夠利用自身卓越的能力來應對行業的周期，並繼續為全球客戶群創造價值。」

集團二零二四年上半年摘要

- 二零二四年上半年錄得銷售收入為港幣 64.8 億元(8.29 億美元)，半導體解決方案分部和表面貼裝技術解決方案分部按年及按半年分別減少 17.1%及 5.8%。
- 集團的新增訂單總額為港幣 63.2 億元（8.09 億美元），按年減少 3.6%，但按半年則增長 11.0%。半導體解決方案分部的新增訂單總額按年及按半年均錄得增長，二零二四年上半年其訂單對付運比率高於一。
- 截至二零二四年上半年，集團的未完成訂單總額為港幣 64.0 億元（8.20 億美元），訂單對付運比率為 0.98。
- 集團的毛利率改善至 40.9%，主要得益於半導體解決方案分部的有利的產品組合。
- 經調整盈利為港幣 3.15 億元，按年因銷售額較低而錄得下降，然而按半年計則錄得增長。
- 集團的流動資金狀況維持穩健，現金及銀行存款總額合共港幣 54.4 億元。

主要受惠於生成式人工智能及高性能計算（「HPC」）應用的殷切需求，集團的先進封裝解決方案於二零二四年上半年佔集團銷售收入的 25%，約為 2.10 億美元，按年有所增長。當中，TCB 解決方案收入貢獻最高，其次是系統封裝及光子解決方案。以下是先進封裝的若干發展亮點：

- TCB: 集團傲視同儕的 TCB 解決方案能夠支援最嚴格的邏輯、記憶體和邊緣端伺服器/裝置應用。
 - 邏輯應用的訂單勢頭於二零二四年第二季度持續。集團贏得來自領先整合設備製造商及外判半導體裝嵌及測試客戶的晶片到晶圓（「C2W」）應用訂單。集團與領先晶圓代工客戶共同開發的新一代無助焊劑 TCB 解決方案正按計劃進行。

- 持續獲得來自集團的領先晶圓代工客戶及其外判半導體裝嵌及測試合作夥伴的晶片到基底（「C2S」）應用方面的重要訂單，以及對在二零二四年餘下時間獲得更多的 TCB 訂單亦充滿信心。
- 至於高頻寬記憶體（「HBM」）方面，集團與主要高頻寬記憶體企業在 12 層及以上堆疊方面的持續合作進展良好。集團於二零二四年七月贏得了兩台下一代無助焊劑 TCB 解決方案的工具訂單。
- 混合式焊接（「HB」）：集團取得重大突破，首次贏得兩台用於高頻寬記憶體應用的新一代混合式焊接工具訂單。
- 光子：作為市場的領導者，由於數據中心對光學收發器增長以迎合生成式人工智能及 5G 網絡的強勁增長，集團接獲顯著的訂單。因應主要人工智能參與者對更快的傳輸速度、更高的頻寬和更低的延遲，集團用於 800G 及更高的光學收發器的解決方案獲得更多動力。
- 系統封裝：繼續取得強勁訂單，需求主要來自全球領先的智能手機廠商對射頻模組、可穿戴設備以及與人工智能和伺服器相關的應用。

汽車市場繼續為集團帶來最大銷售收入貢獻，約佔 24% 或約 2.00 億美元。由於集團提供的汽車解決方案十分全面，即使此關鍵的終端市場放緩，仍繼續帶來強勁的貢獻。半導體解決方案分部及表面貼裝技術解決方案分部來自汽車業務的銷售總收入貢獻相若。就半導體解決方案分部而言，迎合汽車供應鏈若干細分領域的解決方案對銷售收入的貢獻最大，其中包括用於能源及碳化矽模組，以及高端汽車智能 LED 車頭燈的解決方案。表面貼裝技術解決方案分部在靈活應對持續放緩的汽車市場的同時，亦透過轉化未完成訂單總額作出良多貢獻。

集團二零二四年第二季度財務摘要

- 銷售收入為港幣 33.4 億元（4.27 億美元），按季增長 6.5%，高於上一次發布的預測中位數。這主要由於半導體解決方案分部增長，部分被表面貼裝技術解決方案分部的跌幅所抵銷。
- 集團的新增訂單總額為港幣 31.2 億元（3.99 億美元），按季微跌 2.4%，主要受表面貼裝技術解決方案分部所影響，半導體解決方案分部則錄得增長。新增訂單總額按年增長 3.5%。
- 集團的毛利率為 40.0%，較上一季度下降 184 個點子，下降主要由於表面貼裝技術解決方案分部，而半導體解決方案分部保持平穩。
- 經調整盈利為港幣 1.37 億元，按季錄得下降，主要由於為獎勵股份撥備的時機導致本季的經營費用增加。

前景

集團對其先進封裝近期的業務前景仍繼續保持樂觀。然而，由於消費者消費意欲溫和，半導體解決方案分部主流業務需要比預期更長時間才能復甦。此外，表面貼裝技術解決方案分部在短期內繼續面臨市場放緩的勢態。

集團預期二零二四年第三季度的銷售收入將介乎於 3.7 億美元至 4.3 億美元之間（中位數按年下降 9.9%，按季下降 6.4%）。按季下降主要是由於表面貼裝技術解決方案分部的銷售收入下降所致。

憑藉其獨有的廣泛產品組合，集團對其長遠前景及增長潛力依然保持樂觀，集團的信心亦得到包括汽車電動化、智能工廠、綠色基礎設施、5G/6G、物聯網、和於雲端、數據中心及人工智能邊緣端裝置的人工智能增長的長期結構性趨勢所支持。從更廣泛的層面來看，這些結構性趨勢與兩個關鍵領域的持續增長相互呼應：一為個別國家增加通過更多的在岸外包以確保其供應鏈的資本性開支；另為企業正為應對更多變的全球供應鏈做好準備。

關於 ASMPT Limited (「ASMPT」)

ASMPT是一間全球領先之半導體及電子產品製造硬件及軟件解決方案供應商。ASMPT總部位於新加坡，產品涵蓋半導體裝嵌和封裝及SMT(表面貼裝技術)，從晶圓沉積乃至於各種幫助組織、組裝及封裝精細電子組件的解決方案，以便客戶用於各種終端用戶設備，如電子產品、移動通訊器材、計算設備、汽車、工業以及LED(顯示板)。ASMPT與客戶緊密合作，持續投資於研究及發展，開拓具有成本效益和行業影響力的解決方案，為提升生產效率、提高產品的可靠性和質素貢獻力量。

ASMPT在香港聯交所上市(香港聯交所股份代號: 0522)，並且是恒生綜合市值指數下之恒生綜合中型股指數、恒生綜合行業指數下之恒生綜合資訊科技業指數、恒生可持續發展企業基準指數及恒生香港35指數之成份股。詳細資訊請查閱ASMPT網頁<https://www.asmpt.com/>。

前瞻聲明

除歷史事實陳述外，本文所有陳述均是或可能是前瞻聲明。這些前瞻聲明反映 ASMPT 根據現時可得的資料所作出的假設，目前對未來的期望、信念、希望、意圖或策略。此等前瞻聲明並非就未來的表現或事件作出保證，並涉及已知或未知的風險和不確定性。因此，不同因素可能導致實際結果與前瞻聲明中包含的資料有重大差別。讀者不應過分依賴此等前瞻聲明，而 ASMPT 不會承擔任何公開地更新或修訂任何前瞻聲明的義務。本文中無任何陳述有意或可被解釋為盈利預測。

- 完 -

新聞垂詢：

林詒源 (Lim Ee Guan)
企業傳訊總監
電話：+65 6450 1445
電郵：eg.lim@asmpt.com

代表 ASMPT：

縱橫財經公關顧問有限公司
吳燕霞 / 梁頌欣
電話：+852 2864 4812 / 2864 4862
傳真：+852 2527 1196
電郵：mandy.go@sprg.com.hk / vivienne.leung@sprg.com.hk